

平成22年6月2日
三菱製紙株式会社

日本電子回路工業会から、第6回JPCA賞を受賞
銀ナノ粒子インクによる焼成不要な導電性パターン形成技術

三菱製紙株式会社は、ラージ（プリンテッド）エレクトロニクスに適した「銀ナノ粒子インクによる焼成不要な導電性パターン形成技術」の開発で、このほど、社団法人日本電子回路工業会より「第6回JPCA賞（アワード）」を受賞いたしました。

この「JPCA賞」は、日本電子回路工業会が主催する第40回国際電子回路産業展「JPCA Show 2010」、および同時開催の「ラージエレクトロニクスショー2010」、「2010マイクロエレクトロニクスショー」、「JISSO PROTEC 2010」に於いて、併催企画されます出展者製品・技術セミナー「NPI（New Product Introduction）プレゼンテーション」の発表者から選ばれます。

今年は、応募テーマ総数34件の中から、JPCA Show 出展部門から6テーマ、マイクロエレクトロニクスショー出展部門から1テーマ、ラージエレクトロニクスショーから1テーマが受賞しました。当社は、JPCA Show 出展部門での受賞になります。

「銀ナノ粒子インクによる焼成不要な導電性パターン形成技術」は、当社が写真感光材料用として長年扱っている銀と精密多層コーティング技術の組み合わせから生まれた新しい導電性パターン形成技術です。任意の基材に銀ナノ粒子インクを印刷・溶液処理を行い室温程度の低温で導電性パターンを形成することができる湿式処理技術や、銀ナノ粒子インクを印刷するだけで導電性パターンを形成することができる印刷専用基材を開発しております。今後、これら開発品群について順次製品化を行ってまいります。

なお、この当社製品は「JPCA Show 2010」に出展しております。

6月2日（水曜）～4日（金曜） 於：東京ビッグサイト

本件に関するお問い合わせ先：

三菱製紙株式会社

イメージング&ディベロップメントカンパニー 京都R&Dセンター

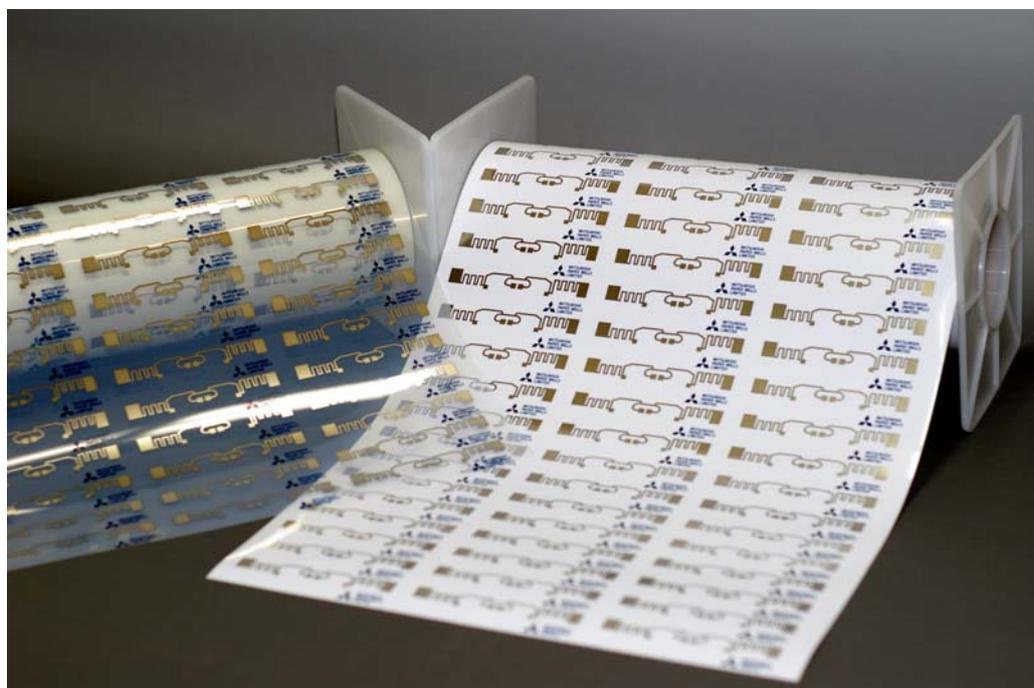
志野 成樹 電話 075-951-1094、 Eメール agnano@mpm.co.jp

※ なお、「2010 マイクロエレクトロニクスショー」は第24回最先端実装技術・パッケージング展、
「JISSO PROTEC 2010」は第12回実装プロセステクノロジー展です。

以上

(参考)

■ インクジェットプリンタを用いて作製したRFIDアンテナイメージ



■ インクジェットプリンタを用いて作成した回路配線イメージ

